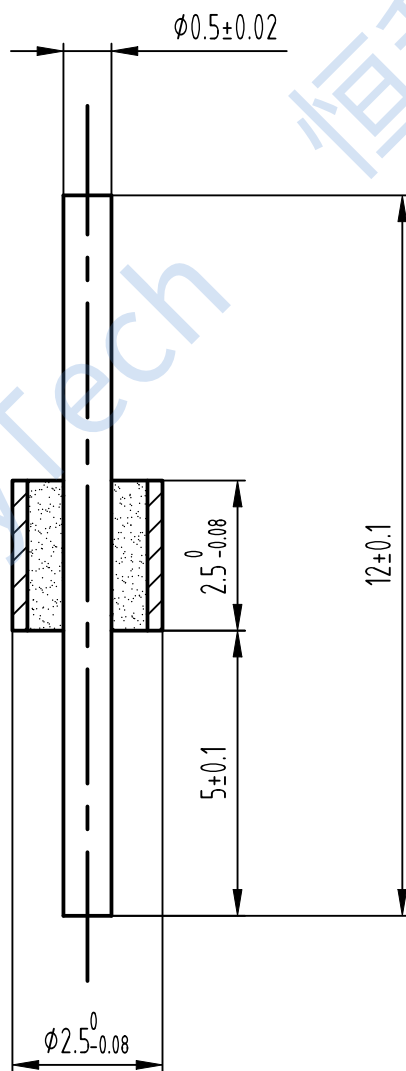




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命： $\geq 500$ 次
5. 温度范围： $-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-DC2525-0.5(12-5)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司  
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

|    |    |       |     |    |  |      |  |     |    |  |     |  |
|----|----|-------|-----|----|--|------|--|-----|----|--|-----|--|
|    |    |       |     |    |  | 图样标记 |  |     | 重量 |  | 比例  |  |
|    |    |       |     |    |  |      |  |     |    |  |     |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期 |  |      |  |     |    |  |     |  |
| 设计 | M。 |       | 标准化 |    |  |      |  |     |    |  |     |  |
| 审核 |    |       |     |    |  |      |  |     |    |  | 8:1 |  |
| 工艺 |    |       | 日期  |    |  | 共 页  |  | 第 页 |    |  |     |  |